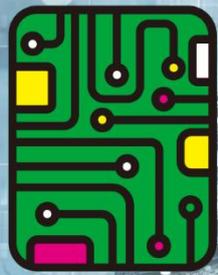


TOPPAN、「くまもと産業復興エキスポ」に出展 半導体産業で活気づく熊本県を DX ソリューション、モノづくりで支援

TOPPAN ホールディングスのグループ会社である TOPPAN 株式会社(本社:東京都文京区、代表取締役社長:齊藤 昌典、以下 TOPPAN)は、2024年2月28日(水)から29日(木)に開催される「くまもと産業復興エキスポ」(会場:グランメッセ熊本)に出展します。

「くまもと産業復興エキスポ」は、2016年の熊本地震や2018年の豪雨災害からの創造的復興が着実に進む中、半導体関連産業の集積に向けた企業進出等により活気づく熊本県の姿を、半導体関連企業や県内製造業による展示・商談を通じて、情報発信、交流を図る展示会です。

KUMAMOTO Industrial Revitalization EXPO 2024



災害からの創造的復興
新生シリコン
アイランド九州の
実現を目指す

2024年
2/28(水)・29(木) 10:00-17:00

くまもと産業復興エキスポ

グランメッセ熊本 〒861-2235
熊本県上益城郡益城町福富1010

TOPPAN ブース(半導体関連ゾーン:4045)では、エレクトロニクス関連商材として、長年ワールドワイドに展開している半導体関連製品をはじめ、工場のスマート点検支援サービス「e-Platch™(イープラッチ)」、TOPPAN 独自の透明蒸着加工技術とコーティング技術を活用した世界最高水準のバリア性能を持つ透明蒸着バリアフィルムブランド「GL BARRIER」、労働災害を VR で体験可能な「安全道場 VR」など、TOPPAN グループの様々な最新商材、サービスを実物展示を交えて紹介します。また、会期中に開催される「ミニステージセミナー」では、TOPPAN のエレクトロニクス事業について紹介します。

■ 主な展示内容

① スマート点検支援サービス「e-Platch™」



「e-Platch™」は無線通信を使用し、点検作業に必要な各種データを自動収集し、見える化するシステムです。アプリケーションの活用により各センサーに設定した閾値を超えた際に自動でアラートメールが送信される為、点検負荷の低減が可能です。後付け設置が可能な DX ソリューションで点検作業の業務改善をサポートします。

・「e-Platch™」製品説明ページ:

<https://solution.toppan.co.jp/smartdevices/service/eplatch.html>

② 透明蒸着バリアフィルム「GL BARRIER」



「GL BARRIER」は TOPPAN グループが開発した世界最高水準のバリア性能を持つ透明蒸着バリアフィルム「GL FILM」を軸とした総合バリア製品ブランドです。「GL FILM」は独自のコーティング層と高品質な蒸着層を組み合わせた多層構造で、安定したバリア性能を発揮します。また多くの優れた特性が高い評価を受け、食品から医療・医薬、産業資材に至る幅広い分野で採用されています。

- ・「GL BARRIER」製品説明ページ:

<https://solution.toppan.co.jp/packaging/service/glfilm.html>

③ 安全道場 VR



安全教育を記憶に残る体感教育に実際に現場で起こりうる 10 種の労働災害を VR で体験可能なオールインワンパッケージです。映像や資料では身につかない、危機体感による効果的な安全教育を可能にします。TOPPAN グループ研修センター「安全道場」監修による製造の現場で起こりうる 10 種の事故についての教育コンテンツがインストール済みのため、届いたその日から現場での安全衛生教育に活用することが可能です。

- ・「安全道場 VR」製品説明ページ:

<https://solution.toppan.co.jp/newnormal/service/safetydojovr.html>

■ミニステージセミナー情報

- ・セミナータイトル: TOPPAN のエレクトロニクス事業の紹介
- ・日時: 2024 年 2 月 28 日(水) 16:00~16:20
- ・会場: 1 階 ミニステージ
- ・講師: TOPPAN 株式会社 エレクトロニクス事業本部
事業戦略本部 マーケティング部 課長 平澤健

■「くまもと産業復興エキスポ」について

- ・名称: くまもと産業復興エキスポ
- ・会期: 2024 年 2 月 28 日(木)~29 日(金) 10:00~17:00
- ・会場: グランメッセ熊本
- ・主催: 熊本県
- ・公式サイト: <https://www.kumamoto-expo.com/#Block03>
- ・TOPPAN ブース: 半導体関連ゾーン(4045)

* 本ニュースリリースに記載された商品・サービス名は各社の商標または登録商標です。

* 本ニュースリリースに記載された内容は発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。

以 上